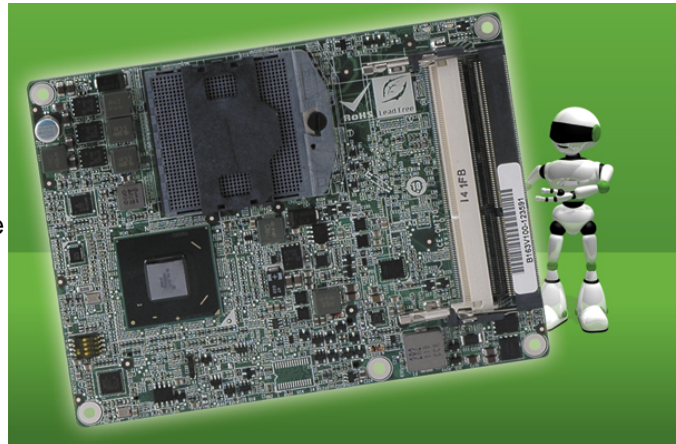


ICE-QM770 – COM Express Board

- COM Express R2.0 Basic Type 6 Board
- Sockel G2 für Intel® 22nm Core™ i7/i5/i3 sowie Pentium® und Celeron® Prozessoren
- Max. 16GB Dual Channel DDR3 SDRAM
- Unterstützt 1.35V DDR3L SDRAM
- Eine 18/24bit Dual Channel LVDS, eine analoge VGA und drei DDI Schnittstellen
- Erweiterung über das Baseboard mit 1 x PCIe x16 und 7 x PCIe x1
- IEI One Key Recovery Funktion



Größte Performance auf kleinstem Raum

Die Computer-on-Module Bauform bietet dem Anwender die Möglichkeit die Leistungsklasse seiner Lösung flexibel anzupassen. Dabei muss er nur ein kompatibles CPU Modul (in diesem Fall ein COM Express R2.0 Basic Type 6) auf sein Baseboard tauschen.

Die ICP Deutschland GmbH kündigt mit dem ICE-QM770 ein COM Express Board an, das über einen Intel® QM77 Chipsatz verfügt und auf seinem G2 CPU Sockel die 3rd Generation Intel® Core™ i7/i5/i3 sowie Pentium® und Celeron® Prozessoren unterstützt. Auf den zwei 204pin Speichersockeln finden bis zu 16GB Dual Channel DDR3 SDRAM Platz. Auch die stromsparenden 1.35V DDR3L Varianten können eingesetzt werden. Der integrierte Intel® HD Graphics 2000/3000 Chip bietet eine VGA, eine 18/24bit Dual Channel LVDS und drei DDI (Digital Display Interface) Schnittstellen. Maximal drei unabhängige Displays können hiermit über das Baseboard realisiert werden. Neben den Standardschnittstellen wie GbE, RS-232, USB 2.0 und 3.0 sowie SATA 3Gb/s und 6Gb/s können auf dem Baseboard auch noch ein PCIe x16 und sieben PCIe x1 Slots für Erweiterungskarten realisiert werden. Das ICE-QM770 bietet größte Performance auf kleinstem Raum.

ICP. Inventive Computer Products

©, ™ Alle Produkte und Markenzeichen sind registrierte Warenzeichen der jeweiligen Firmen.